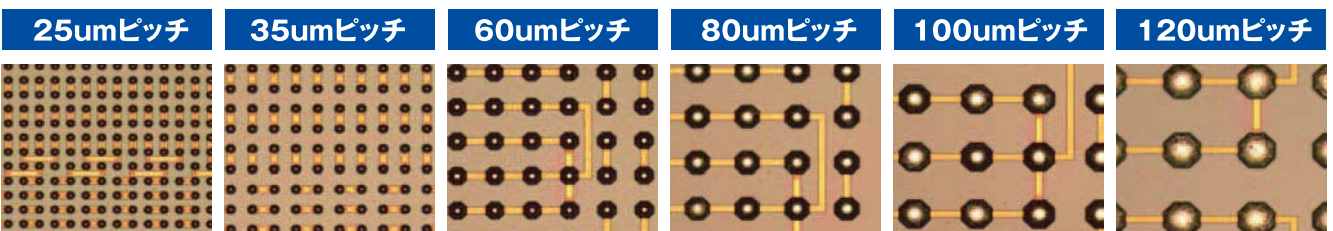
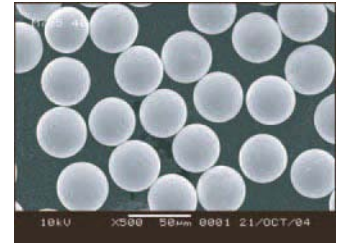
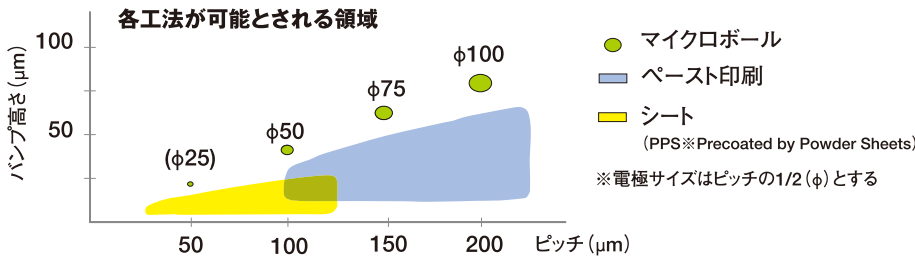


微細接続、高密度、高品質実装に対応

Suitable for fine-pitch interconnection, high-density, high-quality soldering



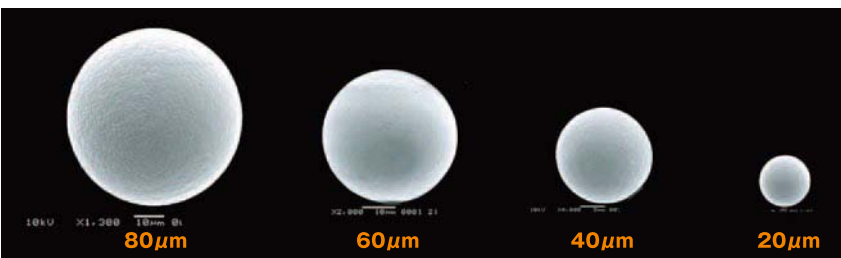
写真提供;長瀬産業株式会社様



ECO SOLDER MICRO BALL ボール/マイクロボール

特長

- 各種組成、各種サイズを用意いたしました



- 製品を『ソフトエラー』から守る、LASマイクロボール



はんだ材料や半導体材料から放出される微量なα線や宇宙線によって、メモリー中のデータが書き換えられる『ソフトエラー』が発生します。特にフリップチップパッケージ等は、ソフトエラーに高感度・敏感であり、はんだ材料など実装用電子材料の低α化が要求されています。LASマイクロボールは、これらの要求を満足する材料です。

<p>■ 標準仕様品</p> <p>球径及び公差 : 50~110μm±3μm</p> <p>アルファカウント : 0.02cph/cm² 未満 0.01cph/cm² 未満 0.005cph/cm² 未満 0.002cph/cm² 未満</p> <p>組成 : M705、M200、その他各種</p> <p>■ 特殊仕様品</p> <p>標準仕様以外につきましては、別途、お問い合わせください。</p>
--

組成系	合金品番組成	熔融温度 (°C)	
		固相	液相
Sn-Ag-Cu 3元系	M31 Sn-3.5 Ag-0.75 Cu	218	219
	M34 Sn-1.0 Ag-0.5 Cu	217	227
	M705 Sn-3.0 Ag-0.5 Cu	217	220
	M715 Sn-3.9 Ag-0.6 Cu	217	226
耐落下衝撃 対策合金	M52 Sn-1.0 Ag-0.1 Cu-0.05 In-0.02 Ni	218	228
既存の高温はんだ (2元系)	M20 Sn-0.75 Cu	227	
	M30 Sn-3.5 Ag	221	
In系 (低耐熱部品用)	M51 Sn-3.0 Ag-0.7 Cu-1.0 In	214	217
	M706 Sn-3.0 Ag-0.7 Cu-1 Bi-2.5 In	204	215
	M716 Sn-3.5 Ag-0.5 Bi-8.0 In	197	214
Sn-Bi系	L20 Sn-58 Bi	139	141